

PCBA焊点失效分析

产品名称	PCBA焊点失效分析
公司名称	深圳市启威测标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘李五路1号科伦特研发楼附属楼101（启威测实验室）
联系电话	0755-27403650 13631643024

产品详情

PCBA焊点失效分析过程一般情况下会按照先无损再有损的方式进行，PCBA组装工艺失效分析针对由PCBA焊点及PCB内部缺陷引起的失效而进行的一系列检测及分析活动。常用分析手段包含但不限于：显微红外分析、金相切片分析、扫描电镜分析以及X射线能谱分析、光学显微镜检查、X-Ray检查、热分析等。

PCBA焊点失效分析项目？

*

焊接工艺异常缺陷分析（枕头效应、虚焊、冷焊、桥连、空洞、芯吸、锡珠等） *

元器件引脚工艺异常分析（镀层分析、污染、氧化、共面性） *

焊点强度分析 * 电化学迁移失效分析 *

腐蚀失效分析（爬行腐蚀、硫化腐蚀等）

更多关于PCBA焊点失效分析信息请致电联系：

手机：13631643024 0755-27403650

邮箱：helen@qwctest.com

网址：www.qwctest.com